94

高感度マルチピクセル光センサの開発

浜松ホトニクス株式会社 電子管設計第1グループ

須山本比呂 suyama@etd.hpk.co.jp

2004年8月5日

1. はじめに

荷電粒子は、その通過に伴ってシンチレーションやチェ レンコフ輻射などのフォトンを発生する。素粒子物理実験 ではこれらフォトンを計測することで荷電粒子の検出・特 定する手法が広く用いられている。したがって、フォトン を検出する光センサが重要な役割を担っており、1 個のフ ォトンに至る感度、1ns以下の高速応答特性に加え、磁場中 動作、マルチピクセル化などの、多くの高い性能が要求さ れるようになってきている。これらに応える光センサを目 指して、電子打ち込み増倍型光センサ(ここでは電子打ち 込み electron-bombarded を略して EB 光センサと称するが、 hybrid photo-detector, HPD とも言われている)を開発した [1],[2]。本稿では、EB 光センサの動作原理を解説し、開発 したマルチピクセル型センサで得られた諸特性を報告する。

2. 動作原理

電子を加速して半導体素子に照射すると、半導体素子中 で多数の電子-正孔対を生成することが、1960年代初頭よ り知られていた。光の入射に応じて光電面より放出した電 子を加速し、このように半導体素子中で高いゲインを得る 光センサ(電子打ち込み増倍型光センサ、EB光センサ)は、 1965年に最初の報告がある[3]。ところが、当時の未熟な半 導体技術ではダイオードのリーク電流が大きかったため、 微弱光計測には向かなかった。

EB 光センサを素粒子物理実験用に開発しようという提 案が改めてなされたのは、半導体技術が十分に進展した 1987 年であり[4]、実用的な EB 光センサが最初に報告され たのは 1991 年である[5]。筆者が EB 光センサの開発に関わ り始めた 1992 年は、ちょうどその頃であった。

EB 光センサは、図1に示されるように、真空中に封じられた光電面と半導体素子よりなる。負の高電圧(たとえば-10kV)が印加された光電面に光が入射し光電子が放出されると、接地電位に置かれた半導体素子との間に形成された電界によって加速されて半導体素子に照射される。電子は、

半導体素子中でエネルギーを失いながら多数の電子-正孔 対を生成するので、これがゲインとなる。このゲインは入 射する電子のエネルギーに依存し数千倍に達するので、ゲ インのゆらぎは原理的に数%と非常に小さい。これが EB 光センサの特長のひとつである。現在も広く利用されてい る光電子増倍管(PMT)は、ダイノードと呼ばれる電極群 で加速と増倍を繰り返しながら10⁶程度の高いゲインを有 するものの、初段の増倍率は10程度と小さく、また、ダイ ノードの入射位置に依存する増倍率のムラが加算されるた め、その増倍ゆらぎは50%を超える。

EB 光センサの総合ゲインは、電子照射ゲインのみでは、 PMT に比べて 3 桁も小さいのだが、アバランシェダイオー ド(AD)を採用して、さらに 50~100 倍のゲインを付加 し、総合ゲインを10⁵ 以上とすることが可能である。AD は 濃度の高い *p* 領域と *n* 領域を接合し、そこでアバランシェ 増倍に十分な高い電界を形成する半導体素子である。



図1 開発したマルチピクセル EB 光センサの動作を示 す模式図 光電面より放出された電子が加速されて半 導体素子に照射されて増倍される。そられは、さらにア バランシェ増倍されて出力される。 EB 光センサに用いる半導体素子は、用途に合わせて、ダ イオード、AD に加え CCD[6]などを用いることが可能であ る。以下では、今回開発したマルチピクセル型 AD を内蔵 した EB 光センサに絞って議論を進める。

3. 設計と製作

1個のフォトンを高い S/N で検出できるように、開発した EB 光センサには AD を採用した。AD は容易にピクセル 化が可能だが、電子線照射による劣化(暗電流の増加)という EB 光センサ特有の課題があるので、図 2 に示す裏面 照射型を採用した。これは、*pn* 接合のない裏面(高濃度 *p* 層)より電子を照射するタイプなので、電子照射による暗 電流の増加がなく長期間安定に動作する。ただし、裏面照 射型 AD は一般的には使用されておらず、電子線を照射した実績もなかったため、予備実験によって動作を確認する ところから開発を始めた。

AD の有効面積は、光電面の有効面積に内接するように 16×16mm²とし、2×2mm²のピクセルを8×8配置した。 図3に開発した AD の写真を示す。

光電面と AD は、9kV の電圧を印加するように、2.5mm の間隔を保って平行平板状に配置した。このような構造の おかげで、センサの軸に平行な磁場中での動作が可能とな る。光電面と AD にかかる電圧は、円筒状のセラミック製 側壁によって絶縁される。



図 2 EB 光センサに採用した AD の断面図 電子は *pn* 接合のない裏面より照射される。



図3 開発した8×8ピクセルAD 電子は裏面より照射され、各ピクセルからの出力は表面側 より取り出される。

EB 光センサは以下の順序で組み立てられる。

バンプボンディングを利用して、AD をセラミック製ス テム上に組み立てる。図4が AD をステム上に組み立て た様子を示している。

ステム外周部にロー付けされた金属フランジと、円筒状 側壁の端部に設けられた金属フランジを突き合わせて 気密が確保されるように溶接する。

この部材と入力ガラス窓を共に真空装置に導入し、昇温して材料のガス出しを行う。

AD が対面する側の入力ガラス窓に、下地となる Sb を 堆積し、その後、アルカリ金属である Na、K、Cs を順 に反応させてマルチアルカリ光電面を作製する。

真空中で入力ガラス窓を移動して側壁に接合させる。気 密は、側壁の端部に溜められたインジウムによってなさ れる。

以上のようにして組み立てられた EB 光センサは、真空装 置より取り出され評価される。組み立ての終了したセンサ の写真を図5に示す。



Ceramic stem

図4 セラミックステム上に組み立てられた AD



図 5 試作したマルチピクセル EB 光センサ ここで示したセンサの入力窓はガラスだが、評価したセ ンサは FOP(本文参照)を採用している。

なお、入力ガラス窓として fiber optic plate (FOP)を採 用した。FOP は光ファイバーを束ねて融着した後、輪切り にし、プレート状にしたものである。入射イメージの位置 を保ったまま出射側に伝えるので、シンチレーションファ イバーからの信号を光電面に導く際に有効である。

4. 諸特性

開発した EB 光センサの諸特性を以下に示す。特性の詳細については、既報[1],[2],[7]を参照されたい。

4.1. ゲイン特性

開発した EB 光センサの総合ゲインは、電子照射ゲイン とアバランシェゲインの積として与えられる。図 6 に、光 電面電圧を横軸として電子照射ゲインを示す。これより、 AD の電子入射面に形成された不感層に対応する閾値があ るが、それを超えるとほぼ 3.6eV で 1 個の電子-正孔対を生 成するという傾き[8]でゲインが上昇するという特性がわか った。二つの結果は、不感層(高濃度 p 層)の厚かった初 期型()と薄くすべく改良を行った高ゲイン型()に 対応する。これより、不感層は電子入射面に形成される高 濃度 p 層の厚さに依存することがわかった。各々の実験値 に対応する実線、破線は、不感層の厚さをパラメーターと して、PENELOPE[9]を用いてゲインのシミュレーションを 行った結果である。高ゲイン型、初期型の不感層を各々 80nm, 210nm としたとき、実験値とのよい一致が見られた。



図6 電子照射ゲイン特性

電子入射面に存在する不感層(高濃度 p 層)の厚い初期型 と、高ゲイン型の特性を示す。実線、および破線は、不感 層の厚さをパラメーターとしてゲインをシミュレートし た結果であり、各々80nm, 210nm に対応する。

ー方、アバランシェゲインは、250Vのバイアス電圧を印 加したときに 22 であった。総合ゲインは、光電面電圧 -9kV における電子照射ゲイン 2100 との積として、 4.6×10⁴ となる。アバランシェゲインは、もっとも耐圧の 低いピクセルのブレークダウン電圧で制限されており、プ ロセスなどの改善により 100 までの向上が見込まれる。

4.2. フォトンカウンティング特性

平均して3光電子程度が放出されるパルス光を光電面に 繰り返し入射し、出力の波高分布を測定した。高ゲイン型 AD、あるいは、初期型 AD を内蔵したセンサで得られた結 果を図7に黒、および、灰色で示す。高ゲイン型 AD を内 蔵した EB 光センサでは、10光電子までを弁別して検出可 能なことがわかった。これは、ゆらぎの少ない電子打ち込 み増倍のおかげであり、PMT では実現し得ない特性である。



図7 マルチフォトンの入射に対応する出力波高分布 黒は高ゲイン AD を内蔵したセンサ、灰色は初期型で得ら れた結果を示している。黒の各ピークは、光電面より放出 した光電子数に対応している。

図7より、初期型に比べて高ゲイン型 AD を内蔵したセ ンサで分解能が格段に改善していることもわかる。これは、 電子入射面の不感層が薄くなることで、そこで損失する電 子エネルギーのゆらぎが小さくなり、有効層で吸収される エネルギー、即ち信号(増幅度)のばらつきが減るためと 考えられる。

4.3. 応答時間特性

パルス幅約 50ps の短パルス光を入射して、EB 光センサ の応答時間特性を評価したところ、ライズタイム 1.1ns、フ ォールタイム 1.7ns と、高速 PMT と同等の高速応答性を示 すことがわかった。その後、毎回 1 個以下のフォトンが入 射する状態に光量を下げ、time to amplitude converter (TAC)を用いてタイミング分解能を測定したところ、図 8 に示すように半値幅で 180ps であることがわかった。

EB 光センサで時間応答特性を決める要因のうち、光電 面・真空中の電子走行時間広がりは共に 1ps のオーダーな ので、時間応答特性を制限する主要な要因は AD といえる。 AD の応答特性は、CR 時定数、および、半導体基板中の電 子走行時間によって決まる。それらを評価したところ、前 者が 0.6ns、後者が 1.3ns であり、半導体基板中の電子走行 時間がセンサの応答時間特性を制限していることがわかっ た。これを改善するためには、CR 時定数で応答特性が制限 されない範囲で基板を薄くすればよい。



図 8 毎回1個以下のフォトンが入射する状態で測定した タイミング分解能

4.4. ユニフォミティ、クロストーク

次に、 *φ*1mm のスポット光をピクセルの中央付近に固定 し、隣のピクセルに現れる信号量(クロストーク)を測定 した。その結果、最近接ピクセルに約1.5%の信号が漏れ出 ることがわかった。主な原因は、入力面として採用した FOP 内での光の散乱と、後述する反射電子であることがわ かった。



図9 ユニフォミティの測定結果 各ピクセルの中央に φ1mm のスポット光を集光して測定 した出力分布であり、標準偏差は6%である。

4.5. 磁場特性

EB 光センサをその軸と平行な磁場中に置き、磁場強度に 対する出力の変動を測定した。図 10 に結果を示すように、 試験装置の最大定格磁場 1.5T まで磁場のないときと同様 の出力が得られた。



図 10 磁場特性 センサと平行な向きに発生させた磁場 強度を変え、出力の変化を測定した結果を示す。

ただ、厳密には、0.5Tまで徐々に出力が増加し、初期値 の約10%増となっている。このとき、隣のピクセルにクロ ストークする信号量が減少していることから、これは、磁 場の効果で正しいピクセルに戻り、そこで信号に寄与して いるためと考えている。

5. まとめと今後の展開

素粒子物理実験で望まれる1個のフォトンの感度、磁場 中での動作、高速応答特性、マルチピクセル動作のすべて を満足する光センサの候補として EB 光センサを開発し、 その特性がすべての項目で実用可能なレベルに達している ことを確認した。

EB 光センサは、本研究で開発した技術を元に、さらなる 高性能化の可能性を秘めている。これは、AD ピクセルサ イズの微細化による多ピクセル化、センサ周辺の不感領域 低減による最密配置の実現、高感度光電面との組み合わせ [2]による高 S/N 化などである。また、本研究で開発したマ ルチピクセル AD を縮小型電子レンズと組み合わせること により、10 インチ程度の大きな有効面積を有するマルチピ クセル光センサへ展開できると考えている。現在、このよ うな光センサは実在しない。

6. 謝辞

本研究は主に、2000年から3年間、総合研究大学院大学 素粒子原子核専攻に在籍中、幅淳二教授をはじめとする多 くの先生方のご指導のもとになされたものです。この場を 借りて感謝の意を表します。

参考文献

- M. Suyama *et al.*, Nucl. Instr. and Meth., A523 (2004) 147
- [2] M. Suyama *et al.*,IEEE Trans. Nucl. Sci., **51** (2004) 1056
- [3] R. Kalibjian, IEEE Trans. Nucl. Sci., 12 (1965) 367
- [4] R. DeSalvo,
 - CLNS, Cornell Univ., Ithaca NY 14853, (1987) 87
- [5] L. K. van Greest and K. W. J. Stoop, Nucl. Instr. and Meth. A310 (1991) 261
- [6] T. Maruno et al., Proc. of SPIE Vol. 3965 (2000) 223
- [7] M. Suyama, KEK Report 2002-16 (2003)
- [8] J. R. Fiebiger and R. S. Muller,

J. Appl. Phys. 43 (1972) 3202

[9] F. Salvat et al., NEA/NSC/DOC 19 (2001)